**申请****新一代信息技术****项目研发补贴办事指南**

一、政策依据

1.《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于加快IAB产业发展的实施意见》（穗开管办〔2017〕77号，以下简称《实施意见》）

2.《广州市黄埔区 广州开发区新一代信息技术产业发展实施细则》（穗开经信规字〔2018〕2号，以下简称《实施细则》）

二、申请条件

（一）申请企业的工商注册地、税务征管关系及统计关系在黄埔区、广州开发区及其受托管理和下辖园区（以下简称本区）范围内，有健全财务制度、具有独立法人资格（或视同法人单位）、独立核算的新一代信息技术企业。申请企业属于新一代信息技术产业领域的集成电路及关键元器件产业；企业是否属于政策扶持范围，按照《集成电路企业认定条件》（见附件）进行认定。

（二）申请的项目研发补贴对应的研发费用应在《实施意见》发布后且在政策有效期内产生。

（三）申请本项补贴的企业，应当设立研发项目的财务辅助账，申请上级和本级财政资助总额不能超过企业项目自筹资金总额，超过部分不予支持。项目已申请上级和本级财政资助的，必须在申请表中明确并对超过企业项目自筹资金总额部分予以核减。

（四）同一法人代表企业、隶属于同一集团企业、关联企业、控股企业、母子公司等相关企业之间互相采购产品和服务不纳入补贴范围。

（五）近3年在申报和承担国家、省、市和区等各级的科技计划项目中无不良信用记录。

三、申请时间

“政策兑现”窗口定期集中受理，具体时间以“政策兑现”窗口通知为准。集中受理事项以当批次规定的最后收件日作为正式收件日期，逾期不申请视同自动放弃。

四、资助标准

（一）集成电路企业研发多项目晶圆（MPW）流片的，按直接费用的80%给予补贴；

（二）集成电路设计企业购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的，按直接费用的40%给予补贴；

（三）集成电路设计企业研发工程片、试流片的，按加工费用的30%给予补贴。

**以上费用须为项目处于研发阶段发生的相关费用，且应归集为“长期待摊费用”“固定资产”“研发费用”“原材料”等科目。对企业将购买的光罩在进行一定研发后又作为商品或原材料进行销售的，不予以补贴。**设计企业购买光罩、研发全掩膜流片的直接费用，与研发工程片、试流片的加工费用难以（不能）进行区分的，统一按照30%给予补贴；各种工艺制程下研发工程片、试流片时，所需的晶圆（wafer）数量应该合理，同样参数的芯片流片累计数量最大不超过25片（单次流片数量超过25片的视为量产，不予补贴，特殊情况附上证明材料并经审核认可后方能补贴）；晶圆厂收取的加工费用包括数量合理的晶圆（wafer）费用。

上述三项补贴，同一企业每年合计最高补贴600万元。

五、申请材料

以下申请材料**一式两份**，用A4纸装订成册并骑缝盖单位公章（需附硬质封面（封面包含企业名称、项目名称、联系人、联系电话，加盖单位公章）、目录列表并添加页码）。除《广州开发区政策兑现事项材料清单》外，其他申请材料需在政策兑现服务信息系统中扫描上传：

1.《广州开发区政策兑现事项材料清单》（该清单在政策兑现服务信息系统预审通过后系统自动生成，请自行打印并在提交纸质材料时一并提交，经办人签名）；

2.《黄埔区 广州开发区新一代信息技术企业研发补贴申请表》（该表包含承诺书；法定（授权）代表人签名，**原件**加盖单位公章；若委托代理人签名的，须提交授权委托书，复印件加盖单位公章）；

3.企业“一照一码”营业执照（复印件加盖单位公章）；

4.申请补贴项目的研发费用专项审计报告（审计报告包括但不限于项目涉及资金明细表；复印件，加盖单位公章）；

5.《申请补贴项目涉及资金明细表》（**原件**，加盖单位公章）；

**说明：**应该按照费用类别（按照上述“四、资助标准”中费用分类，下同）分别列明，包括凭证日期、凭证号、费用类别、合同号、金额、流片数量、光罩（或全掩模即Full MASK）数量、发票号、付款回单号、经费来源、费用小计、有关涉及汇率及日期等情况备注，应能清晰界定以下费用类别：

（1）企业研发多项目晶圆（MPW）流片的直接费用；

（2）企业购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的直接费用；

（3）企业研发工程片、试流片的加工费用。

6.记账凭证（复印件，加盖单位公章）；

7.委托协议或代工合同（复印件，加盖单位公章）；

**说明：**根据申请费用补贴的类别，分别提供；委托第三方服务机构与晶圆厂进行流片、加工、制造的，需出具相应的完整的业务流程（申请单位—委托方—晶圆厂）材料或凭证。

8.发票（境外加工的需提供等效凭证，复印件，加盖单位公章）；

9.付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）（复印件，加盖单位公章）；

**上述要求的记账凭证、合同、发票、付款凭证应依次排序，按照每一个申报项目、每一笔金额单独、有序分开（分别按项目一、项目二……明确隔开），杜绝材料杂乱无章并由申报单位承担相应责任。**

10.产品研发情况说明（**原件**，加盖单位公章）；

11.研发项目财务辅助账（复印件，加盖单位公章）；

12.产品外观照片（**原件**，加盖单位公章）；

13.区科技行政主管部门拨付新一代信息技术企业研发补贴的文件（仅获得过补贴的单位须提供，需提供最新获得拨款的通知文件并用荧光笔划出申请单位名字，复印件，加盖单位公章）；

14.统计关系证明材料：

①“规模以上企业”进入“广东省企业一套表平台”（国家统计局一套表系统），打印“调查单位基本情况表”和“财务状况表”盖章确认，并提供最新的月报和上一年度的年报。

②“规模以下企业”，到注册地所属街道统计站打印《查看法人单位表》并盖章确认；若企业信息变更，则由企业提供情况说明并盖章确认；

15.**首次**向区科技主管部门申请新一代信息技术产业发展扶持资金的企业，还需提交如下资料：

（1）企业主要产品（服务）情况说明（包括但不限于产品、服务的名称、执行标准、主要用途等）（**原件**，加盖单位公章）

（2）由具有资质的第三方机构出具的上一年度审计报告（当年度设立的企业，提供半年度审计报告）（复印件加盖单位公章，**核原件**）；

（3）上一年度纳税申报表一套（当年度设立的企业无需提供）（复印件加盖单位公章，**核原件**）；

（4）企业最近一个年度的新一代信息技术产品（服务）收入明细账（复印件，加盖单位公章，**核原件**）；

（5）新一代信息技术产业领域的相关知识产权证明材料（复印件加盖单位公章，**核原件**）。

16.申请集成电路设计企业奖励的（即设计企业购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的补贴，研发工程片、试流片的补贴），应提供本企业为权利人的《集成电路布图设计登记证书》至少1份（复印件，加盖单位公章，**核原件**）。

**实质审核通过后，登录政策兑现服务信息系统在线办理资金拨付申请：**

1.《收款确认函》（加盖单位公章并上传**原件的彩色扫描件**；上传《收款确认函》之前，请务必确认系统中的单位名称及银行账户等信息准确无误）。

2.若单位信息有变更的，需及时修改系统资料信息，并上传《工商变更登记备案通知书》、企业银行基本户《开户许可证》等**原件的彩色扫描件（若单位名称与《资金批复》的单位名称一致，则无需提供）**。

六、受理部门

广州开发区政策研究室“政策兑现”窗口（窗口地址：广州市黄埔区香雪三路3号广州开发区政务服务中心3楼C区349号窗口）

联系电话：82114062 邮箱：zcdx@gdd.gov.cn

七、业务主管部门

广州市黄埔区科学技术局（广州开发区科技创新局）

联系电话：82118897、82111943（产业处）

八、受理时间

周一至周五：上午：9:00-12:00 下午：1:00-5:00

（国家法定节假日按有关规定另行执行）

九、办理时限

21个工作日（形式审核时限：5个工作日；实质审核时限：7个工作日；资金拨付时限：5+4个工作日）

（以上办理时限扣除法定节假日、公休日；扣除组织专家评审论证、公示所需的时间以及与上级部门业务信息系统等区外部门的业务信息系统核实所需的时间；其他需要扣除时限的特殊情况。）

十、办理流程

（一）申请人访问http://zcdx.gdd.gov.cn登录广州市黄埔区广州开发区政策兑现服务信息系统并下载填写打印《黄埔区 广州开发区新一代信息技术企业研发补贴申请表》。申请人在政策兑现服务信息系统登录后，申请事项预审。“政策兑现”窗口对事项预审通过后，申请人按照办事指南要求带齐纸质材料到“政策兑现”窗口递交，正式提出申请；“政策兑现”窗口经办人员对纸质材料进行初步审核后，予以收件。

（二）对材料齐备的政策兑现申请，区政策研究室形式审核通过后，转送业务主管部门进行实质审核；对于形式审核未通过或需要补正申请材料的，5个工作日内通知申请人。

（三）业务主管部门实质审核通过后，进行为期3个工作日的公示，公示无异议后，出具批复并转交政策研究室“政策兑现”窗口。

（四）实质审核通过后，申请人登录广州市黄埔区广州开发区政策兑现服务信息系统在线办理资金拨付申请。

（五）业务主管部门收到区政策研究室转交的资金拨付资料后统一办理资金核拨手续。

（六）区财政国库集中支付中心办理资金拨付手续。

附件：集成电路企业认定条件

附件

**集成电路企业认定条件**

根据政策要求，申请新一代信息技术企业研发补贴的企业，应为集成电路产业企业。申请单位是否属于集成电路产业企业，按照以下条件进行认定。

一、申请企业属于新一代信息技术产业领域的集成电路及关键元器件产业，主要产品或服务在国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)代码属于3971、3972、3973、3974、3975、3976、3979、3981、3983、3984、3985、3989、6520，详见附表；

二、企业在集成电路领域的研发费用支出占年度研发费用支出的50%以上，或者企业在集成电路及关键元器件方面的产品或服务收入占该年度销售收入的50%以上；

三、申请认定为集成电路设计企业，必须提供本企业为权利人的《集成电路布图设计登记证书》；

四、由专家根据企业提交的材料进行综合判定，60%以上专家确认方可。

**附表 国民经济行业分类和代码**

| 代码 | 类别名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |
|  | **39** |  |  | **计算机、通信和其他电子设备制造业** |  |
|  |  | 397 |  | 电子器件制造 |  |
|  |  |  | 3971 | 电子真空器件制造 | 指电子热离子管、冷阴极管或光电阴极管及其他真空电子器件，以及电子管零件的制造 |
|  |  |  | 3972 | 半导体分立器件制造 |  |
|  |  |  | 3973 | 集成电路制造 | 指单片集成电路、混合式集成电路的制造 |
|  |  |  | 3974 | 显示器件制造 | 指基于电子手段呈现信息供视觉感受的器件及模组的制造，包括薄膜晶体管液晶显示器件（TN/STN-LCD、TFT-LCD）、场发射显示器件（FED）、真空荧光显示器件（VFD）、有机发光二极管显示器件（OLED）、等离子显示器件（PDP）、发光二极管显示器件（LED）、曲面显示器件以及柔性显示器件等 |
|  |  |  | 3975 | 半导体照明器件制造 | 指用于半导体照明的发光二极管（LED）、有机发光二极管（OLED）器件等制造 |
|  |  |  | 3976 | 光电子器件制造 | 指利用半导体光—电子（或电—光子）转换效应制成的各种功能器件制造 |
|  |  |  | 3979 | 其他电子器件制造 | 指其他未列明的电子器件的制造 |
|  |  | 398 |  | 电子元件及电子专用材料制造 |  |
|  |  |  | 3981 | 电阻电容电感元件制造 | 指电容器（包括超级电容器）、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造 |
|  |  |  | 3982 | 电子电路制造 | 指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，以及附有无源与有源元件的制造，包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件 |
|  |  |  | 3983 | 敏感元件及传感器制造 | 指按一定规律，将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出的敏感元件及传感器的制造 |
|  |  |  | 3984 | 电声器件及零件制造 | 指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件等制造 |
|  |  |  | 3985 | 电子专用材料制造 | 指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等 |
|  |  |  | 3989 | 其他电子元件制造 | 指未列明的电子元件及组件的制造 |
|  |  | 399 | 3990 | 其他电子设备制造 | 指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造 |
| **I** |  |  |  | **信息传输、软件和信息技术服务业** | 本门类包括63～65大类 |
|  | **65** |  |  | **软件和信息技术服务业** | 指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务 |
|  |  | 652 | 6520 | 集成电路设计 | 指IC设计服务，即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务 |

**黄埔区 广州开发区新一代信息技术**

**企业研发补贴申请表**

**申请补助类别**（在相应的［］内打“√”）：

 1. 研发多项目晶圆（MPW）------------［］

 2. 购买光罩、研发全掩膜-------------［］

2. 研发工程片、试流片---------------［］

**单位名称（公章）**：

**联系人**：

**联系电话**：

**电子邮箱**：

**填报日期**： 年 月 日

**承诺书**

我单位承诺：

1.对细则相关奖励政策及约定已知悉，申请事项符合相关政策、细则和办事指南等要求，所有提交的文件材料真实，不存在弄虚作假行为。

2.自收到本次补助的10年内，注册及办公地址、统计关系不迁离本区，不改变在本区的纳税义务，并积极配合主管部门相关监督检查。

3.近3年在申报或承担国家、省、市、区科技计划项目中无不良信用记录。

4.本次申请的项目费用为项目处于研发阶段发生的相关费用，且归集为“长期待摊费用”“固定资产”“研发费用”“原材料”等科目，购买的光罩在进行一定研发后不作为商品或原材料进行销售。

如有违反上述规定，本单位应主动退回领取的相关扶持资金；如不主动退回，区业务主管部门有权全额追回。

法定代表人签字：

日期：

（单位盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 实际办公地址 |  |
| 注册时间 |  |
| 是否拥有《集成电路布图设计登记证书》 | □是 （若有，请填写最主要的1件布图设计名称与登记号） □否 |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| **研发项目一** |
| **研发项目名称** | **费用类型** | **费用金额****（万元）** | **申请补贴金额****（万元）** |
|  | **研发多项目晶圆（MPW）流片的直接费用** |  |  |
|  | **购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的直接费用** |  |  |
|  | **研发工程片、试流片的加工费用** |  |  |
| 产生业务关系和费用的主体之间是否属于“同一法人代表企业、隶属于同一集团企业、关联企业、控股企业、母子公司等相关企业之间互相采购范围”：□是 □否。 |
| 该研发项目是否已获得上级和本级财政资助（□是 □否），若已获得上级和本级财政资助的，请在下列表格中填写扶持事项名称、扶持金额和资金到账时间，并在下面的申请补贴总额中对超过企业项目自筹资金总额部分予以核减。 |
| 享受补贴的受理部门 | 扶持事项名称 | 资金到账时间 | 扶持金额（万元） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |
| 企业项目自筹资金总额（万元） |  |
| 申请补贴金额（万元） |  |
| **研发项目二** |
| **研发项目名称** | **费用类型** | **费用金额****（万元）** | **申请补贴金额****（万元）** |
|  | **研发多项目晶圆（MPW）流片的直接费用** |  |  |
|  | **购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的直接费用** |  |  |
|  | **研发工程片、试流片的加工费用** |  |  |
| 产生业务关系和费用的主体之间是否属于“同一法人代表企业、隶属于同一集团企业、关联企业、控股企业、母子公司等相关企业之间互相采购范围”：□是 □否。 |
| 该研发项目是否已获得上级和本级财政资助（□是 □否），若已获得上级和本级财政资助的，请在下列表格中填写扶持事项名称、扶持金额和资金到账时间，并在下面的申请补贴总额中对超过企业项目自筹资金总额部分予以核减。 |
| 享受补贴的受理部门 | 扶持事项名称 | 资金到账时间 | 扶持金额（万元） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |
| 企业项目自筹资金总额（万元） |  |
| 申请补贴金额（万元） |  |

（如有更多符合条件的项目，可以自行添加表格和数据）

**申请情况汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **费用类型** | **申请补贴金额****（万元）** | **企业项目自筹资金总额（万元）** | **核定金额（万元）（本栏由审核部门填写）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

**注：金额精确到元，舍去元位后的尾数；“企业项目自筹资金总额”须与专项审计报告数据一致。**

**附件材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 页数 |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 申请补贴项目的研发费用专项审计报告（复印件，加盖单位公章），包括但不限于项目涉及资金明细表。 |  |
| 3 | 《申请补贴项目涉及资金明细表》（复印件，加盖单位公章） |  |
| 4 | 记账凭证（复印件，加盖公章） |  |
| 5 | 委托协议或代工合同（复印件，加盖公章） |  |
| 6 | 发票（境外加工的需提供等效凭证，复印件，加盖公章）； |  |
| 7 | 付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）（复印件，加盖公章） |  |
| 8 | 产品研发情况说明 |  |
| 9 | 研发项目财务辅助账 |  |
| 10 | 产品外观照片 |  |
| 11 | 统计关系证明材料 |  |
| 12 | 区科技行政主管部门拨付新一代信息技术企业研发补贴的文件（仅获得过补贴的单位须提供，需提供最新获得拨款的通知文件并用荧光笔划出申请单位名字，复印件，加盖单位公章） |  |
| 13 | 第一次向区科技主管部门申请新一代信息技术产业发展扶持的企业，还需提交如下资料：（1）企业主要产品（服务）情况说明（包括但不限于产品、服务的名称、执行标准、主要用途等）；（2）上一年度审计报告（当年度设立的企业，提供半年度审计报告）；（3）上一年度纳税申报表一套（当年度设立的企业无需提供）；（4）企业最近一个年度的新一代信息技术产品（服务）收入明细账；（5）新一代信息技术产业领域的相关知识产权证明材料；（6）集成电路布图设计登记证书(仅申请集成电路设计企业奖励的（即设计企业购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的补贴，研发工程片、试流片的补贴提供）。 |  |

**申请补贴项目涉及资金明细表**

项目名称：

项目期间：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **记账凭证日期** | **记账凭证号** | **费用类别** | **合同号** | **数量** | **金额** | **发票号** | **付款金额** | **付款回单号** | **经费来源** | **页码范围** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表格可以根据填写内容的增加行数；“项目名称”及“项目期间”根据该项目的实际情况填写；“费用类别”应按指南规定的三类费用填写；
2.“记账凭证日期”应填两个：收到发票时的记账凭证日期，加括弧填写支付时的记账凭证日期，示例：2021.04.01（2021.04.30），“记账凭证号”同理；

3.涉及外汇支付的情况，应在“金额”列后插入“外汇金额”、“汇率”、“、”订单（PO）号”三列；在“备注”列写出汇率时间，并提交汇率说明。

**业务流程图**

政研室形式审核 (5个工作日)

申请人到“政策兑现”窗口提交纸质材料，正式提出申请

科技局会议研究

下达批复文件

业务主管部门办理资金拨付手续（5个工作日）

对材料齐备无误的政策兑现申请，区政策研究室形式审核通过后，转送业务主管部门进行实质审核；对于形式审核未通过或需要补正申请材料的，5个工作日内通知申请人。

征求相关部门意见

科技局科技产业处经办人提出拟办意见

(6个工作日)

公示（3个工作日）

政研室转交企业出具的资金确认函1个工作日

支付中心办理支付手续（3个工作日）

科技局科技产业处经办人填单（2个工作日）

科技局报账员审核（2个工作日）

科技局副局长审核（1个工作日）

业务主管部门审核（7个工作日）

公示时间不受时限限制